國 立 交 通 大 學

工學院半導體材料與製程設備學程

碩 士 論 文

50um CuNi/SnAg 金屬墊層覆晶銲錫凸塊之電遷移研究

Study of Electro-migration for Flip-Chip Solder bumps with 50um CuNi/SnAg

研 究 生：江詩寬

指導教授：陳 智 教授

中 華 民 國 一百 年 七 月

50um CuNi/SnAg 金屬墊層覆晶銲錫凸塊之電遷移研究

Study of Electro-migration for Flip-Chip Solder bumps with 50um CuNi/SnAg

研 究 生：江詩寬　　Student：Shih-Kuan Chiang

指導教授：陳智　　Advisor：Chih Chen

國 立 交 通 大 學

工學院半導體材料與製程設備學程

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Degree Program of Semiconductor Material and Process Equipment

College of Engineering

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

in

Semiconductor Material and Process Equipment

July 2011

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百年七月